Tarjeta de iluminación XLE-S22XPL-BV2E3



Descripción de Producto.

La tarjeta basada en la mejor tecnología de LEDs última generación; familia XLamp XPL HD de CREE® y SINKPAD® que nos brinda excepcional desempeño, eficiencia y expectativa de vida. El producto puede proveer más de 3,000 lumens de flujo luminoso, y está diseñada para desarrollo de iluminación en general de alta intensidad, reemplazando así otras tecnologías como lo son halógenas y fluorescentes.

El producto es compatible con la óptica secundara LEDIL® de la familia STRADA 2x2 (se venden por separado); la óptica secundaria ofrece diferentes patrones de distribución incluyendo tipo II (alumbrado público) y HB (simétrico 60°), lo que nos brindará beneficios adicionales para poder desarrollar diferentes aplicaciones de forma más eficiente, con una excelente confiabilidad y precisión.

Características de Producto.

Temp. de Color (CCT): 5000K (ANSI C78.377A)

IRC (CRI): 70 min.

Tiempo de vida (L70): $> 51,400 (T_a/T_{sp} = 85^{\circ}C @ 2.1A)$

(LM-80 disponible)

Especificaciones de Producto.

Diodo Emisor de Luz (LED) por Tarjeta:	4 (Serie)
Material de Tarjeta:	MCPCB SINKPAD®
Interconexión:	Pad Soldar
Aislamiento al Medio Ambiente:	ND *
Temperatura Máxima de Operación:	125°C @ 2.4A
Dimensiones:	
Montaje	Adhesivo / Tornillo

^{*} IP67 a través de adhesivos o materiales compatibles con el LED y Óptica



Powered by: CREE

SinkPAD

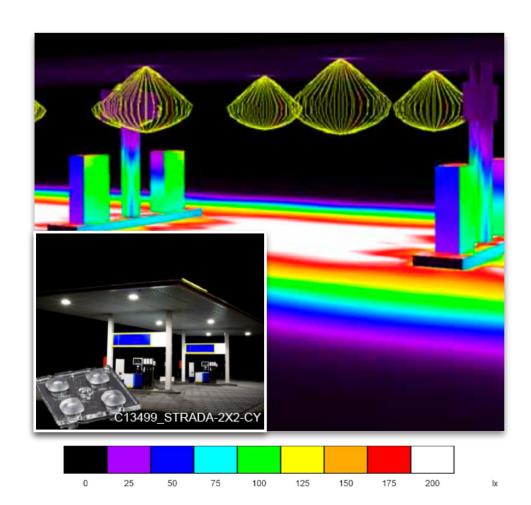
Cooling Matters...

Especificaciones Técnicas. (Tsp = 85°C)

	Mín.	Típ. A	Típ. B	Máx.	
Corriente de Operación:	0.35	1.40	2.40	3.00	Α
Voltaje de Operación:	11.0	12.1	12.8	13.2	V_{DC}
Flujo Luminoso Mínimo:	586	2,003	3,013	3,498	lm
Eficiencia:	152.4	118.7	98.2	88.4	lm/W
Potencia:	3.8	16.9	30.7	39.6	W

Alerta: La tarjeta XLE-S22XPL necesita estar sujeta a un disipador correspondiente con la potencia de operación y es OBLIGATORIO utilizar material térmico de interface (TIM) entre el disipador y la tarjeta, para reducir las perdidas por resistencia térmica.

Simulación - Luminaria ~80W utilizando tarjetas XLE-S22XPL



Descripción:

La simulación utiliza 4 tarjetas XLE-S22XPL-BV2E3 para desarrollar una luminaria para una estación de servicio ~80W.

- 4 tarjetas XLE-S22XPL-BV2E3E @ 1.5A
- Óptica secundaria LEDIL® STRADA-2X2-CY (4x)
- CCT: 5000K (ANSI C78.377A); CRI: 70 min
- Flujo Luminoso [Tarjeta x 4]: 8,466.4 lm @ 116.3 lm/W
- Flujo luminoso [Luminaria]: 7,958.6 lm @ 98.4 lm/W **
- Potencia [Luminaria]: ~80.1W **
- Distancia entre Luminaria: 5.00 m por 5.00 m
- Altura de Instalación: 4.00 m
- Luminancia:
- Promedio: 200 lx
- Alrededor de las bombas 80 200 lx

^{** 85°}C Tsp, Eficiencia Óptica: 94% (LEDIL® STRADA-2X2MX-DWC), Eficiencia Driver: 90%

Catálogo Materiales de Interfaz Térmica



THERMAL PAD - GAP FILLER

Este material ofrece una mejoría en rendimiento térmico y adaptabilidad. Se ajusta a las irregularidades de la superficie entre un MPCB y un disipador térmico. Es eléctricamente no conductor y naturalmente pegajoso, por lo que generalmente no se requiere adhesivo adicional.

La formulación patentada del material cumple con los estándares libres de sustancias peligrosas (RoHS) así como libre de halógenos, proporcionando seguridad adicional en aplicaciones donde estas sustancias peligrosas están prohibidas.

Productos de Línea*

P00426

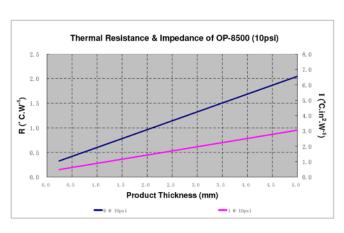
- Grosor 0.508 mm
- XLE-M26 / -S26

P00427

- Grosor 0.508 mm
- XLE-M22XH / -S22XH

P00428

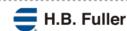
- Grosor 0.508 mm
- XLE-M22 / -S22



^{*} Nota: Configuraciones y dimensiones especiales de hasta 12" x 16" son posibles bajo pedido.

PROPIEDADES	VALOR
Construcción y Composición	Elastómero de Silicon y Fibra de Vidrio; Suave
Color	Violeta
Grosor en pulgadas / (mm)	0.02" ~ 0.40" (0.508 ~10.16) incrementos 0.01" (0.254)*
Formato	Configurable*
Densidad (g . cm³)	2.98
Dureza (Shore 00)	40
Resistencia a la tracción (psi)	34
Seguridad a la Inflamabilidad UL	UL94 V0
Rango de Temperatura (°C)	-40 ~200°C
Conductividad Térmica (W/m . °C)	3.0
Voltaje de Ruptura (V)	>6000 (Grosor <= 0.04") >10000 (Grosor >= 0.05")
Resistencia Volumétrica (ohm . cm)	8.0 x 10 ¹³
Costante Dielétrica @ 1MHz	12.4

FH1003 - PASTA DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA



FH1003 es un pasta térmica no secante que es fácilmente aplicable a temperatura ambiente.

Características y Beneficios

- Una parte, fácil de dispensar, no requiere mezclado adicional.
- 100% sólido, sin solventes, plastificantes, o componentes de baja volatilizad.
- Conveniente tiempo de apertura para antes de su uso.
- No conductor, no corrosivo.

Preparación de la Superficie y Limpieza

Contaminantes como aceite, polvo, corrosión y mugre afectan negativamente la adhesión de cualquier adhesivo. Los substratos deben ser

tapados cuando son almacenados. Cualquier notable partícula o aceite debe ser retirado antes de la manufactura. Limpie tan pronto como sea posible. Utilizar guantes protectores cuando retire el material. Limpiar con solventes industriales, tales como Éster Dibásico (DBE). Metil Etil Cetona (MEK) o Alcohol Mineral.

FH7012 - ADHESIVO DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 🗧 H.B. Fuller



FH7012 es un adhesivo térmico que cura con acelerador (P19732). Recomendado como interfaz entre fuentes de calor Aluminio/Cerámico y disipadores térmicos. Presentación: Jeringa 30ml / 300ml Cartucho

Características y Beneficios

- Una parte, no requiere mezclado adicional.
- Curado rápido
- Bajo olor
- Alta resistencia de unión.
- Excelente desempeño térmico.

Instrucciones de Uso

- Área de adhesión debe estar limpia, libre de suciedad y aceites. La superficie tiene que estar totalmente seca antes de aplicación.
- El acelerador se pulveriza o se recubre sobre una superficie donde se encontrará el material adhesivo.
- Acelerador se vuelve volátil después de unos cinco minutos.
- Se aplica el adhesivo a la superficie a pegar.
- Aplicar presión suficiente a la unión para asegurar el espesor deseado.
- Tiempo de Ajuste <= 3 min. / Tiempo de Curado 24 horas @ 25°C

PROPIEDADES	VALOR
Color	Beige
Vida de Almacén (meses)	6
Temperatura de Aplicación (°C)	25
Gravedad Específica	1.65
Conductividad Térmica (W/m . °C)	0.6

Típico Sin Curado

PROPIEDADES	VALOR
Color	Gris
Químico	Acrilato
Viscosidad (Pa.s @ 25°C, CP 52, 1rpm) cps	80000
Densidad (g/cm³)	1.9
Valor Tixotrópico (TI)	5.9

Típico Curado

Dureza (Shore D)	70
Conductividad Térmica (W/m . °C)	1.0
Resistencia Volumétrica (ohm . cm)	5.6 x 10 ¹⁴
Resistencia Superficial (ohm . cm)	2.0 x 10 ¹⁴
Fuerza Dialéctica (KV/mm)	26.3